


プログラム

日時 2017年7月21日(金) 9:30-18:30

会場 横浜ベイホテル東急(総合受付 B2F)

K-1 基調講演 同時通訳						
9:30-11:00	ご挨拶		日本ケイデンス			
	ケイデンス講演	Systems to Silicon: Faster and Smarter	米国ケイデンス Dr. Anirudh Devgan			
	招待講演	ホンダのヒューマノイド研究経緯と今後に向けて (株)ホンダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパン 重見 聡史 氏				
Room A	Room B	Room C	Room D	Room E		
デジタルIC設計/ サインオフ	PCB/ IC-Package設計	機能検証/ システム設計検証	カスタムIC設計	IPソリューション/ System Design Enablement		
11:20-12:00	A-1 革新的スピード! サインオフ DRCを数日から数時間へ ~次世代物理検証ツール Pegasus Verification Systemのご紹介~ 日本ケイデンス	B-1 Discover What's New in Sigrity 2017 & IC Package Design and Analysis Methodology 米国ケイデンス	CD-1 テクニカル・キーノート: システム機能検証に向けた 包括的なソリューション Cadence Verification Suite 米国ケイデンス	E-1 同時通訳 先端ノード、最新プロトコル、 多様なプロセッサ要求に 対応するケイデンス IPソリューションのご紹介 日本ケイデンス		
12:00-13:00 Lunch						
13:00-13:40	A-2 RTL電力解析ツールを用いた HEVC 4K/60P 低電力ビデオ CODECのLSI開発 (株)ソシオネクスト	B-2 OrCADセッション OrCAD製品及び 関連ソリューションのご紹介 イノテック(株)	C-2 シミュレーション高速化に向けて: ケイデンス社の第三世代機能 シミュレータXceliumに対する 東芝の取り組み 東芝デバイス&ストレージ(株)	D-2 深層学習を用いた演算増幅器の 性能と素子値の関係の推論 群馬大学 大学院理工学府	E-2 内視鏡画像にCNN特徴を適用 した大腸がん診断支援システムの テンソリカVision P6 DSPによる リアルタイム処理の実現 広島大学	
13:50-14:30	A-3 TSMC/12FFCプロセス 製品開発における Innovusの レイアウト高親和性による 高パフォーマンス実現 Global Unichip Japan(株)	B-3 JTAGバウンダリスキャンテストの 容易化設計を支援する OrCAD@Captureの無償プラグイン 富士設備工業(株) 車載アプリケーション向け システムレベル検証ソリューション MathWorks Japan/イノテック(株)	C-3 PalladiumZ1上での 大規模検証に向けた カバレッジ強化の取り組み 富士通(株)	D-3 ESD/EMを考慮した 素子形状検討の新技术 東芝マイクロエレクトロニクス(株)	E-3 四元数Extreme Learning - Machine ニューラル ネットワークのXtensaへの 実装と性能評価 兵庫県立大学大学院	
14:40-15:20	A-4 東芝ASIC開発の設計TAT改善に 貢献する Genus-Physical Synthesis Solution 東芝マイクロエレクトロニクス(株)	B-4 モデルベース開発を推進する 高精度モータモデルJMAG-RTと OrCAD@Pspice連携事例紹介 (株)JSOL/イノテック(株)	C-4 Pespac System Verifierに よるMCU機能検証の効率改善 ルネサスエレクトロニクス(株)	D-4 多様化する先端テクノロジーと ケイデンスのソリューション、 Virtuoso ICADV12.3 米国ケイデンス	E-4 TOPPERS Automotive Kernelの テンソリカ・プロセッサ及び DSP適用事例紹介 日本ケイデンス	
15:20-15:50 Coffee Break						
15:50-16:30	A-5 ルネサス車載SoC・マイコン製品に おける電源ノイズ設計・Voltus 適用事例 ルネサスエレクトロニクス(株)	B-5 社会ソリューション事業を支える ハードウェア開発・生産体制の 構築に向けたケイデンスとの取組み 日本電気(株)	C-5 XceliumとJasperGoldの カバレッジをコンバイン!! ~シミュレーションとフォーマルの 融合検証による検証効率化への取り組み~ メイビス デザイン(株)	D-5 フラッシュメモリ設計における 課題と設計環境での施策 東芝メモリ(株)	E-5 ISO26262規格要求対応の ためのツール導入評価 (IFSS・LBIST) ローム(株)	
16:40-17:20	A-6 圧倒的な実績と性能、 最新Innovus17.1がリリース!! ~すぐに適用したくなる機能を もれなく紹介~ 日本ケイデンス	B-6 Allegro同時並行設計機能 を利用した基板実装手法の紹介 (株)日立情報通信エンジニアリング	C-6 JasperGoldを用いた 機能検証サインオフの 最新トレンド 日本ケイデンス	D-6 OpenAccessを用いた アナログIP・ミックスドシグナル 製品向けアナログ・デジタル 協調レイアウト設計環境のご紹介 ルネサスエレクトロニクス(株)	E-6 車両電子情報分野における マイコン利用と期待 (株)デンソー	
17:20-18:30 Cadence Beer Station						
Designer Expo						
11:00-17:20	Sponsors: グローバルファウンドリーズ / Samsung / TSMCジャパン(株) / ClioSoft / UMC ams AG / Helic, Inc. / 三重富士通セミコンダクター(株) / OneSpin Solutions / タワージャズ ANSYS medini Technologies AG / コンピュータダイナミクス(株) / MathWorks Japan/ (株)モーテック / 東芝デバイス&ストレージ(株) / 東芝マイクロエレクトロニクス(株)			Cadence Solutions システム設計検証 機能検証 デジタルIC設計/サインオフ カスタムIC設計 PCB/IC-Package設計 IPソリューション		



ケイデンス・ビア・ステーション
皆様のコミュニケーションの場として、
冷たいビールやお飲み物を用意しておりますので、
お気軽にお立ち寄りください。

素敵な景品が当たるお楽しみ抽選会、パートナー様からのプレゼント抽選会も
ご用意しております。是非ご参加ください。

詳細・ご登録はこちらから <https://www.cadence.com/cdnlive/jp>